



Rf. 11736

P/N. BX8071512900K

PROCESADOR INTEL CORE I9-12900K 3.20GHZ SOCKET 1700

Esenciales Colección de productos Procesadores Intel® Core i9 de 12.ª generación Nombre clave Productos anteriormente Alder Lake Segmento vertical Escritorio Número de procesador i9-12900K Litografía Intel 7 **Especificaciones de la CPU** Total Cores 16# de núcleos de rendimiento 8# de núcleos eficientes 8 Total de subprocesos 24 Frecuencia turbo máxima 5.20 GHz Frecuencia de la tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0 5.20 GHz Frecuencia turbo máxima de núcleo de rendimiento 5.10 GHz Frecuencia turbo máxima de núcleo eficiente 3.90 GHz Frecuencia base del núcleo de rendimiento 3.20 GHz Frecuencia base de núcleo eficiente 2.40 GHz Cache 30 MB de caché inteligente Intel® Total L2 Cache 14 MB Potencia base del procesador 125 W. Potencia turbo máxima 241 W. **Especificaciones de memoria** Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria) 128 GB Tipos de memoria Hasta DDR5 4800 MT / s Hasta DDR4 3200 MT / s Cantidad máxima de canales de memoria 2 Ancho de banda de memoria máximo 76,8 GB / s **Gráficos del procesador** Gráficos del procesador Intel® UHD 770 Frecuencia de base de gráficos 300 MHz Frecuencia dinámica máxima de gráficos 1.55 GHz Salida de gráficos DP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 Unidades de ejecución 32 Resolución máxima (HDMI) 4096 x 2160 a 60 Hz Resolución máxima (DP) 7680 x 4320 a 60 Hz Resolución máxima (eDP - Panel plano integrado) 5120 x 3200 a 120 Hz Soporte DirectX *12 Soporte OpenGL *4.5 Motores de códec multiformato 2 Vídeo de sincronización rápida Intel® sí Tecnología Intel® de video nítido HD sí# de pantallas admitidas 4 ID del dispositivo 0x4680 Soporte OpenCL *2.1 **Opciones de expansión** Direct Media Interface (DMI) Revision 4.0 Cantidad máxima de carriles DMI 8 Escalabilidad Solo 1 S Revisión de PCI Express 5.0 y 4.0 Configuraciones de PCI Express Hasta 1x16 + 4, 2x8 + 4 Cantidad máxima de carriles PCI Express 20 **Especificaciones del paquete** Sockets compatibles FCLGA1700 Configuración máxima de CPU 1 **Especificación de solución térmica** PCG 2020 AUNIÓN EN T100°C Tamaño del paquete 45,0 mm x 37,5 mm **Tecnologías avanzadas** Acelerador neuronal y gaussiano Intel® 3.0 Director de subprocesos Intel® sí Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) sí Compatible con memoria Intel® Optane 8225; sí Tecnología Intel® Speed Shift 8203; 8203; Shifts sí Tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0 8225; sí Tecnología Intel® Turbo Boost 8225; 2.0 Tecnología Intel® Hyper-Threading 8225; sí Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) 8225; sí Tecnología de virtualización Intel® para E / S dirigida (VT-d) 8225; sí Intel® VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT) 8225; sí Intel® 64 8225; sí Conjunto de instrucciones 64 bits Extensiones de conjunto de instrucciones Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 Estados inactivos sí Tecnología Intel SpeedStep® mejorada sí Tecnologías de monitorización térmica sí Dispositivo de gestión de volumen Intel® (VMD) sí **Seguridad y confiabilidad** Nuevas instrucciones de Intel® AES sí Clave segura sí Protección del sistema operativo Intel® sí Ejecutar bit de desactivación 8225; sí Protector de arranque Intel® sí Control de ejecución basado en modo

(MBE) sí Tecnología Intel® Control-Flow Enforcements sí

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.